

MINISTERIO DE INDUSTRIA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



- 3 MAYO 1978

CONCEDIDA
PATENTE DE INVENCION

| | | |
|-------|-----------------------|--------|
| 19 ES | 11 NUMERO | 10 A 1 |
| | 21 | |
| 22 | FECHA DE PRESENTACION | |
| | 23-9-77 | |

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| 30 PRIORIDADES: | 32 FECHA | 33 PAIS |
| 31 NUMERO | | |
| P 26 43 087.5 | 24 de Septiembre de 1.976 | Alemania. |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 47 FECHA DE PUBLICIDAD | 51 CLASIFICACION INTERNACIONAL | 62 PATENTE DE LA QUE ES DIVISIONARIA |
| | 12/6 | |

| |
|--|
| 64 TITULO DE LA INVENCION |
| Procedimiento para la fabricación de condensadores de capas. |

| |
|---|
| 71 SOLICITANTE (S) |
| SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, de Berlin y München, entidad alemana. |

| |
|---|
| DOMICILIO DEL SOLICITANTE |
| residente en Wittelsbacherplatz 2, D-8000 München 2, República Federal Alemana. |

| |
|-----------------------------|
| 72 INVENTOR (ES) |
| Georg DAHMS., Hubert KRAUS. |

| |
|-----------------|
| 73 TITULAR (ES) |
| |

| |
|-------------------------------------|
| 74 REPRESENTANTE |
| D. Jose Miguel Gomez-Acebo y Pombo. |

La presente invención se refiere a un procedimiento para la fabricación de un condensador de capas, en el que se enrollan sobre un tambor con gran diámetro una o varias espiras de capas de dieléctrico y armaduras, en el que después de conseguido el número de capas necesario se bobinan capas separadoras de material sintético sobresalientes a ambos lados de las capas de dieléctrico, en el que sobre estas capas separadoras se enrollan nuevamente capas de dieléctrico y armaduras, en el que así se disponen unos sobre otros varios condensadores matriz formando un condensador de partida, en el que mediante capas metalizadas se cubren completamente los lados frontales del condensador de partida y mediante ello se contactan frontalmente, y en el que el consumidor de partida se atempera y se divide a lo largo de las capas separadoras en distintos condensadores matriz y perpendicularmente a la dirección de las láminas en condensadores individuales.

Un procedimiento de este tipo es conocido por la memoria de patente alemana 1 764 541. En ella las capas separadoras en tanto sobresalgan de los condensadores matriz se desprenden y tiran al dividirse el condensador de partida. En la producción en grandes cantidades de tales condensadores ésto significa un notable gasto de material y un coste de trabajo no despreciable.

El cometido que fundamenta a la presente invención consiste por una parte en aprovechar las ventajas de las capas separadoras sobresalientes, concretamente una sencilla división de los condensadores matriz también en la zona de las capas Schoop, y por otra parte en evitar el desperdicio de material.

Este cometido se soluciona según la invención porque las capas separadoras de material sintético se pegan con el con

5. condensador matriz producido encima, y porque las partes sobresalientes de las capas separadoras se eliminan por esmerilado después del contactado frontal. Se dá una forma de ejecución especialmente limpia de este procedimiento porque las capas separadoras se abrillantan en un lado. En este caso la adhesión después de atemperado el condensador de partida basta para originar la necesaria unión. Puede ajustarse una fuerza de adherencia deseada más alta, recubriéndose o lacandose las capas separadoras con un material que no origine un pegado con las láminas contiguas hasta la atemperación.

10. La ventaja de la presente invención consiste en que a consecuencia de que sobresalen las capas separadoras el adhesivo no entra en contacto con aquellas láminas a las que no debe de pagar. Esto se efectuaría en la zona de los cantos de las láminas separadoras si éstas, como en el estado de la técnica, no sobresaliesen de las láminas de dieléctrico. Además mediante la eliminación por esmerilado de las partes de las capas separadoras sobresalientes y eventualmente pegadas con poca firmeza, se garantiza que el pegado se efectue con seguridad hasta la zona marginal. Esto en esta construcción importante ya que las capas separadoras que quedan como capas cubridoras en el condensador individual no están ya unidas con el restante condensador mediante las capas metalizadas.

15. El condensador matriz enrollado sobre las capas separadoras puede protegerse mecánicamente del modo en si conocido mediante una capa de capas intermedias que se enrollan primeramente, las cuales quedan como capas cubridoras en el condensador individual después de la división en condensadores individuales. Estas capas intermedias no sobresalen convenientemente de las capas de dieléctrico, con el fin de que éstas se abarquen por las

20.

25.

30.

capas Schoop y así se mantengan independientes de un eventual pegado adicional por las capas Schoop.

5. La presente invención se aclara ahora con detalle a base de una figura. La figura muestra un condensador de partida según la invención en vista parcialmente seccionada y partida.

10. Sobre un tambor 3 se han fabricado condensadores matriz 1, 11 los cuales están enrollados a partir de láminas de material sintético 7 y 8 metalizadas, desplazadas entre sí. Las armaduras 9 y 10 que constan de varias espiras de en cada caso una metalización están contactadas mediante la correspondiente capa Schoop 4.

15. Entre ambos condensadores matriz 1, 11 están dispuestas dos espiras de una lámina separadora, como capas separadoras 5 las cuales se pegaron entre sí y con el condensador matriz 1 situado debajo, mediante capas de laca 2 durante el proceso de atemperación. La parte sobresaliente de las capas separadoras 5 se eliminó ya por esmerilado en un lado, de manera que las capas separadoras presentan allí un canto esmerilado 6 que se halla en la zona del borde exterior de la capa metalizada 4. La capa de laca 2 adhesiva no puede alcanzar las capas del condensador matriz 11 que se hallan sobre las capas separadoras 5. Mediante esto estas capas pueden separarse sin más a lo largo de las capas separadoras 5.

25. Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

5. 1.- Procedimiento para la fabricación de condensadores de capas, en el que se enrollan sobre un tambor con gran diámetro como mínimo una espira de capas de dieléctrico y armaduras, en el que después de conseguido el número de capas necesario se bobinan capas separadoras de material sintético sobresalientes a ambos lados de las capas de dieléctrico, en el que sobre estas capas separadoras se enrollan nuevamente capas de dieléctrico y armaduras, en el que así se disponen unos sobre otros varios condensadores matriz formando un condensador de partida, en el que mediante capas metalizadas se cubren completamente los lados frontales del condensador de partida y mediante ello se contactan los lados frontales del condensador de partida y mediante ello se contactan frontalmente, y en el que el condensador de partida se atempera y se divide a lo largo de las capas separadoras en distintos condensadores matriz y perpendicularmente a la dirección de las láminas en condensadores individuales, caracterizado porque las capas separadoras de material sintético se pegan con el condensador matriz acabado de enrollar en cada caso, pero no con el condensador matriz que está por encima, y porque las partes sobresalientes de las capas separadoras se eliminan por esmerilado después del contactado frontal.
- 10.
- 15.
- 20.

2.- Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque las capas separadoras se abrillantan en un lado.

25. 3.- Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque las capas separadoras se recubren o lacan con un material que no origina un pegado con las láminas contiguas hasta la atemperación.

30. 4.- Procedimiento para la fabricación de condensadores de capas, tal y como queda sustancialmente descrito en la pre-

sente Memoria y en el dibujo adjunto.

Esta Memoria consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara.

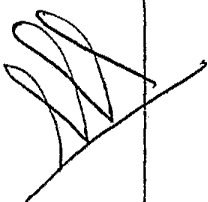
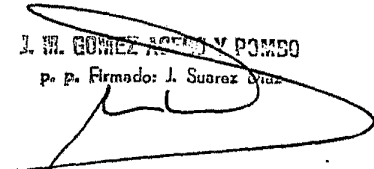
Madrid,

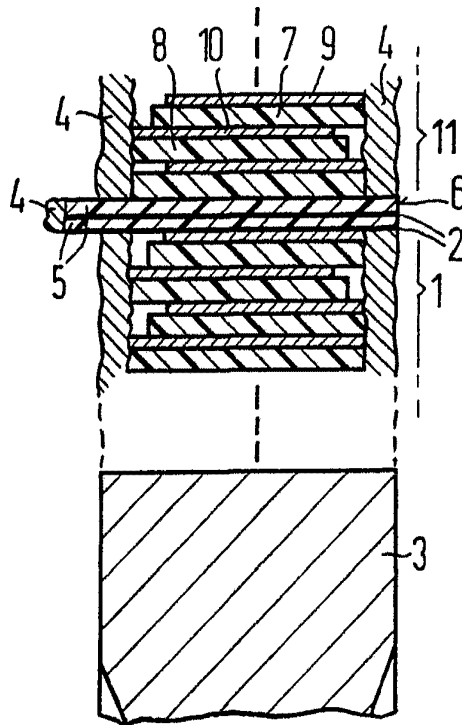
30 NOV. 1977

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, de
Berlin y München.

J. W. GOMEZ AGUIRRE Y POMBO

p. p. Firmado: J. Suarez Diaz





ESCALA
VARIABLE
50 NOV. 1977

Elaborado por: J. Y. Ponce
p. J. Elmerdo, J. Gomez Diaz